

印刷电路制造工艺

中国科学院上海无线电技术研究所
材料元件研究组编

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书介绍几种印刷电路的具体制造工艺，这些工艺各有特点，可以适应各种不同的生产条件。书中首先介绍制图的几种工艺，然后把三种切实可行的印刷电路制造工艺分别详细介绍，可作无线电机件和精密仪器生产上的参考。

印 刷 电 路 制 造 工 艺

中国科学院上海无线电技术研究所材料元件研究组编

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业登记证093号

上海市印刷四厂印刷 新华书店上海发行所总经售

开本 350×1168 档 1/32 印张 1 4/32 字数 28,000

1959年9月第1版 1959年9月第1次印刷

印数 1—5,000

统一书号：15119·1325

定 价：(十二) 0.19 元

前　　言

由于电子技术的迅速发展，在电子设备的工业生产方面，迫切需要新的工艺方法来适应。在成套机器生产方面，装配工序是一个主要的关键問題，装配工艺在过去都是用接綫方法。这种接綫方法有一定的缺点，主要是：人工較多，不能搞自动化生产；接綫时錯誤不能避免，并且需用很多的导綫。因此印刷电路工艺的发展就很有必要。采用印刷电路的优点甚多，主要是：便于搞生产自动化，省工、省料，装配容易，可靠性大，不会因接綫錯誤而返工，尤其是調整、檢驗等工时可大大减少。但印刷电路也有它的缺点，例如所印电路的附着强度不够，以及修理檢查时較困难等等，这些是印刷电路在今后需要研究和改进的。

印刷电路的制造方法有几十种之多，但能符合电子技术和生产工艺上要求的却不多，目前能广泛应用的工艺方法更少。經過实际研究与試制，符合生产工艺要求，經得起电性能及其他方面考驗的，目前只有三种，这三种都已能投入生产。这三种是：銅箔腐蝕法、化学沉积法和轉移压塑法。其他的工艺虽还在进行研究及試制，但还没有結論，所以現在只重点地介紹以上三种工艺方法。我們在这方面的工作还进行得不久，沒有很好的經驗，当然还存在着一定的缺点，写这本工艺的原意只是将进行試制的情况作一介紹，希望有关研究此項問題的同志們，加以指正。

目 录

前言

| | |
|------------|----|
| 1. 制图工艺 | 1 |
| 1-1 絲网漏印法 | 4 |
| 1-2 照相复印法 | 9 |
| 1-3 胶版轉印法 | 11 |
| 1-4 描繪法 | 11 |
| 2. 銅箔腐蝕法工艺 | 12 |
| 3. 化学沉积法工艺 | 19 |
| 4. 轉移压塑法工艺 | 30 |



制图工艺

印刷电路制图时，首先将需要装配的零件安排妥当，按一定的排列方法布置好线路。在制图时先用一块标准板，这板上要有一定尺寸的格距，这种尺寸可由设计者自行规定，普通是2~3毫米（图1）。利用格子来安排零件，这样就可将线路和接线孔系统化起来。零件的排列必须整齐防止零乱，因为零件分布有规律，对

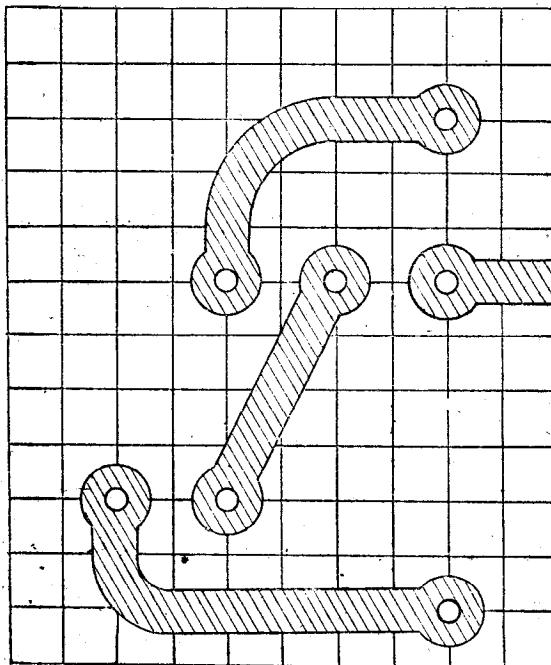


图1 利用格子安排零件，将设计的电路系统化

生产进一步机械化有很多好处。另一方面零件的布置必须安放在一面。接线的布置也尽可能不要分布在两面，两面布线在以后进行的工艺中，会带来很多的困难。如果零件和导线全都布置在一面，那末就便于检查，要机械化生产时也方便了。

制图时要考虑接线的宽度及接线之间的空隙，接线的宽度一般是1.5~3毫米；空隙的距离是要根据以后所采用的工艺方法来决定的，若用照相版法就可制到1.5毫米，但也不要小于1.5毫米，因为过小的空隙在焊接时会造成短路（图2）。

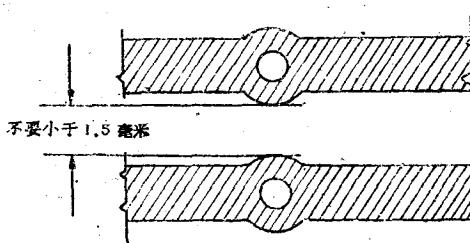


图2 导线之间的空隙不要小于1.5毫米
在图2中，导线之间的空隙太小，会导致短路。因此，在设计时必须避免这种情况。如果实在不能避免，只有设计在另一面上。但这种两面布线只能用在化学沉积法工艺及铜箔腐蚀法工艺中，而不能在转移压塑法工艺上应用了。两面布线还要考虑连接的方法，化学沉积法工艺比较简单，只要利用金属化孔（图3）就可将两面的线连接，铜箔腐蚀法只能用空心铆钉来连接（图4）。

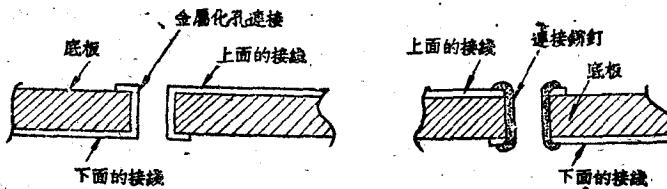


图3 用金属化孔连接

图4 用空心铆钉连接

接线的布置要避免棱角，改变方向的地方不要成锐角，要设计成圆形（图5）。曲线的内半径R不要小于2毫米，导线的接线孔四周应当要比孔大4~6毫米，并设计成圆形（图6）。

另外，穿线的孔要比零件的导线直径大一点，普通可大0.5毫米左右，这样在焊接时会增加强度。

如果用化学沉积法工艺，在设计制图时就必须要安排出工艺导线，以利以后电镀加厚工艺的进行。这种工艺导线可安排在线路板的四边，或者是

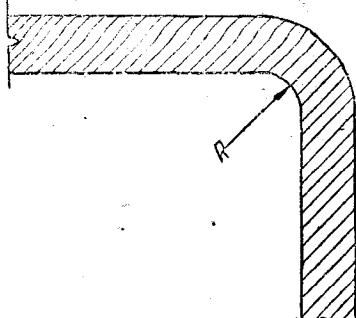


图 5 R 不应小于 2 毫米

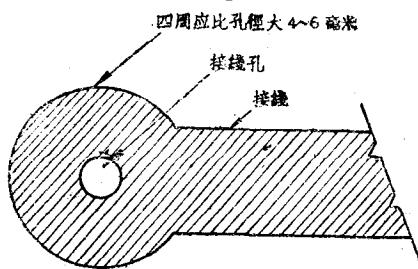
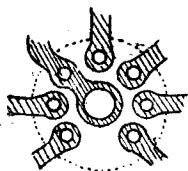


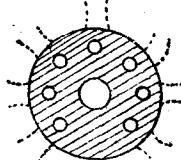
图 6 接线孔四周应设计成圆形

集中在几个点。安排在四边的方法对以后拆除导线时比较简单，只要磨去四边就可以了。集中到几个点最好是集中到管座和较大的零件地方比较妥当，这样可利用金属化孔，将连接点集中在背面（图7），这样对拆除导线时方便得多。

绘制图样时，可先在标准板上安排好大型零件后，再安排较小的零件，最后再绘连接线。用于照相版工艺上的图样最好放大4~6倍来绘制，然后经过照相缩小到需要的尺寸，这样可得到精密的底



正面导线



利用金属化孔在背面将导线连接

图 7 集中在背面的连接方法

图。繪制线路的图纸要用沒有反光的图画紙，并且一定要用黑色繪图墨水来繪制，繪出的线路图形要黑白分明，这样就便于制版。

印刷图形的質量，会直接影响线路的精密度。印刷的方法有好多种，而現在采用的有四种：即(1)絲网漏印法，(2)照相复印法，(3)胶版轉印法，(4)描繪法。这四种方法各有它的优缺点，可根据不同的要求来加以选择采用。絲网漏印法的最大优点是設備简单，普通的生产足可适应；它的缺点是精密度不高。照相复印法优点是精密度高，但手續麻烦，不适用于大量生产。胶版轉印法是具有以上两种工艺方法的优点，生产率高，精密度也能符合要求，但設备費用較大。描繪法是一般做样子时用的方法，在初步試样时，利用这种方法来描繪一块，比較方便。

1-1 絲网漏印法

絲网漏印法和鏤空板印刷方法相同，絲网漏印法的优点是制版容易，比鏤空板精密，这种印刷方法現在很广泛地应用在美术工艺上，例如收音机刻度盘、广告牌等。絲网漏印法的工艺过程有制版、刮印、烘干三項。主要的关键是在制版，制出版子的质量和以后印制出的线路关系很大。制版的方法有两种：一种是漆膜雕刻法，另一种是光化学法。这两种方法各有优缺点，前一种方法操作简单，但精密度因受雕刻工艺的限制，不易达到較高的要求；后一种方法操作时很繁复，需經過照相、晒版等一系列手續，但制出的网版精密度較高。一般要求不高、尺寸較大的图形以采用雕刻法工艺比較适合；尺寸小、精密度要求高的以采用光化学法为适合。这两种工艺的制版方法如下：

甲、漆膜雕刻法 工艺程序：

(1) 准备木框 木框可采用复写油印机的現成木框(图8)，将原来的絲絹取下，另外用四根与拆下絲絹后留下的凹槽一样厚薄的木料，以便另外綁上要用的絲网。

(2) 緼絲网 緼網可采用 150~200 目的絲絹，很平整地用制好的木条縊紧在木框上。

(3) 底图准备 根据实际需要的尺寸，先在蜡纸上繪出需要的线路，再用晒图方法晒出原图。

(4) 上凡士林 将凡士林放在紗布中，順着图纸在一个方向上先涂抹一道，另换一方向順着抹一道，再反过来重复抹一道，要很均匀地在图样上涂上一层凡士林，使紙面光滑，但不得堆积油层。

(5) 噴漆膜 用軟性硝棉漆（皮革用清噴漆）20 克加入香蕉水 40 毫升，再加入醇溶性染料少許（不可太多，多了会看不出图样上线路），充分混和后，放在噴漆枪中。另外将涂好凡士林的图纸，平整地摊放在板上，四角用图釘釘住，将軟性清漆均匀地噴上一次，等它干后（或放在 30°C 烘箱中烘 5 分鐘），再噴第二次漆。这样反复地噴四次（横二次直二次），干后便成为漆膜。这时可先切下一小块，进行檢驗，檢驗方法是在边上用尖刀刻划两条并行線，将漆膜挑一下，以能把漆膜順利地揭起为合格，否則需再加噴漆层。

(6) 雕刻线路图形 用尖头雕刻刀，在噴过漆的图纸上，按照漆膜下透过来的线路图形，輕輕划过，以刻破漆膜而不刻着底下图纸为度。刻好后挑去不需要的漆膜，留下需要的图形。需要留下怎样的图形可根据要制的是阴紋版或阳紋版来决定。用在銅箔腐蝕法工艺上的是阴紋版，那末将刻后的中間线路挑去，留下阴紋图

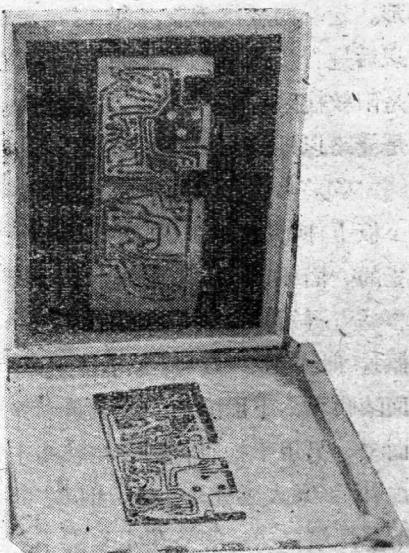


图 8 利用普通油印机来改制絲网漏印设备

形。这种阴纹图形版，漏印时可以在铜箔的表面印出阳纹的线路，以后进行腐蚀工艺时起保护作用。用于化学沉积法工艺时的图形是阳纹线路，与铜箔法工艺要求恰恰相反，所以漆膜刻好后挑去的是线路以外的四周阴纹，以后制成的网版就是阳纹的。

(7) 落版 将刻好后的漆膜，挑去不需要的地方，平整地摊在平板上，四角用图钉钉紧，将糊好丝绢的木框，对准线路图形。丝绢的一面要緊貼住漆膜图形，木框没有丝绢的一面朝上，压住不可移动，再用棉花蘸一点香蕉水(不可太多)，在丝绢上用力均匀地擦过，时间约2~3秒钟，不可太久，使香蕉水湿润丝绢而透到下面漆膜上。下面的漆膜因香蕉水作用而表面溶解，透到丝绢上面来。另用干纱布将剩余在丝绢上的香蕉水吸干。擦时不能有气泡，面积太大应分几次擦，面积小的可以一次擦完。但擦过的地方不要擦第二次。等香蕉水全部干后，取下图钉，将木框连同图纸一同翻过来，小心地将图纸撕下，这时漆膜留在丝绢上。撕图纸时要特别小心，不要将漆膜连着撕下。这样落版的工序就完成了。

(8) 修版 修版是一件细心的工作。在上面各道工序中，如有不妥或版面损坏之处，必须在修版工序中加以补救。修版时需将原图样放在丝网下，对准图形检查，若有破损不妥之处，可用笔涂补硝棉漆，最后还必须用放大镜来检查一次。修补完毕后，另用硝棉漆将图版四周的丝网涂满，干后制版工艺即全部完毕。

乙、光化学法制丝网版 工艺程序：

(1) 制图 绘制图形时必须根据原图尺寸加以放大(约4~6倍)来绘，这样，绘制时容易准确，以后经过照相缩小到需要的尺寸时，就可以得到精密的线路图形。

(2) 制照相的底片 必须要反差性强，即黑白分明，一般习惯是叫硬片；这种底片，专门用于制版方面，不适用于拍人像的。要拍这种底片，可委托徽章厂或制版厂代拍，所拍的底片若用于腐蚀法的，是阳纹底片，即拍后再翻一次；沉积法用的是阴纹底片。

(3) 木框上绷絲絹 木框上绷絲絹的工艺和上述漆膜雕刻法中的工艺相同。

(4) 配感光液 配方如下：

| | |
|--------------|--------|
| 聚乙烯醇或白明胶 | 10 克 |
| 重鉻酸銨(10% 溶液) | 5 毫升 |
| 水 | 100 毫升 |

先将聚乙烯醇溶解于热水中，待全部溶解后，用紗布滤过，再将重鉻酸銨溶液加入混和。加入重鉻酸銨溶液时，不要在直射光线的地方进行，要在暗室配制。配好的胶液，貯放于深顏色的玻璃瓶中，并且不要露光。

(5) 絲网上涂感光液 将木框平放在玻璃板上，绷絲絹的一面贴平在玻璃上，将感光液倒在木框內絲絹上，用橡皮刮板向四面刮平。感光液不要太多，以正好涂滿絲絹网孔为度，倒去多余的感光液后，就在电炉上烘干。

(6) 曝版 将阳紋底片与絲絹正面（靠木框的一面）贴紧，底片上再放一块玻璃，四边用夹子夹紧。曝光主要是用炭精灯，如果没有，也可在日光下曝光。日光由于时间和位置不同，感光时间亦不同，要根据日光强弱来决定曝光时间。曝光时间夏天約1分鐘，冬天約3分鐘，阴天要加长时间。大量生产时，用炭精灯較易控制，生产效率亦高，制品正确。

經過曝光后即可将夹子放松，取下玻璃及底片，絲网上即可看出图形，接下去就可进行显影。

(7) 显影 显影液的配方如下：

| | |
|------|--------|
| 硫氰化銨 | 10% 溶液 |
| 氯化鈣 | 10% 溶液 |

显影时，将曝光后的絲网胶版，用棉花浸硫氰化銨溶液，浸洗二次，在50°C溫水中浸一下，用棉花浸氯化鈣溶液洗一次，即可浸入冷水中漂洗，再用蓮蓬头冲洗一次，水勢要緩，冲后可再重复浸

硫氰化銨及氯化鈣溶液，再在水中漂洗至清淨为度；然后用干毛巾将水吸干，在干燥箱中以 80℃ 溫度烘干。

(8) 修版 烘干后的絲网版，若有針孔及不妥当的地方，可用硝棉漆加以修补，必須注意的是除了線路之外，所有四邊的絲网必須用硝棉漆涂滿漏孔，免得在印刷时，漏下不需要的涂料。

絲网版制好以后，还要进行两个工序，就是括印和烘干。

甲、刮印 将上面任何一种工艺制成的絲网版，进行印刷工序时，先将木框装到油印机的彈簧架子上，开始定位。定位的方法是先在架子面上鋪一張白紙，用胶水粘住；将彈簧架上的絲网放下，用擦好涂料的橡皮刮板刮印一次。若用于銅箔腐蝕法的，可用耐酸漆作涂料；若用于化学沉积法的要用耐酸耐碱的涂料，这种涂料上海已有生产（长城牌印刷电路用漆）。刮印后放起絲网版，白紙上即印有線路图形。另用透明玻璃紙将印好的图形蒙住，能透露出图形而不会弄糊，这样就可用冲好眼的底板在上面定位，以管座孔或較大零件的孔做基准。

刮印时，先用紙刮印几次，到印出来的图形清楚，沒有中断及印不出的地方，才可用底板正式刮印。刮印时要順一个方向刮，用力要均匀，若刮印不清楚可順原刮印方向，重新刮一次，但不可多刮，否則線路就会臃肿模糊，造成返工。刮印时数量不論多少要連續不断地全部刮印完毕；若中途停止，在要再印时必須洗版，否则就会印不出来，或者印出来模糊不清楚。洗版时可用汽油或苯洗刷，洗过的版必須达到絲网上的線路沒有漆迹为度，并用清洁干燥紗布或棉花吸干洗液。

乙、烘干 把刮印好的底板平放在架子上，进行烘干，溫度 120℃，時間大約 30 分鐘，烘干后即可进行腐蝕。这道工序不做亦可进行腐蝕，但容易将印出的線路碰坏。

1-2 照相复印法

照相复印工艺，适用于銅箔腐蝕法；制出来的綫路非常精密。其缺点是手續麻煩，产量不高，不适宜于大規模生产，但对要求精密的仪器能起一定的作用。工艺程序如下：

(1) 底板表面处理 有銅层的底板，先經处理才能使用，因为氧化膜和不清洁地方，对质量有很大的影响。处理的方法是先将带有銅层的底板，用木炭在銅面上擦磨，将表面擦得沒有反光，并且十分干淨，用清洁干布擦干，再用脫脂棉浸酒精，擦洗表面一次。

(2) 配感光胶 配方：(亦可用前面光化学法的感光液配方)

| | |
|--------------|--------|
| 白明胶 | 20 克 |
| 蛋白液 | 2 克 |
| 重鉻酸銨(10% 溶液) | 10 毫升 |
| 鉻酸(10% 溶液) | 1 毫升 |
| 水 | 140 毫升 |

将白明胶先用水浸过夜，再在水浴中溶解，蛋白可用鷄蛋白。处理时先将蛋白与蛋黃分开，将蛋白外包的白膜除去，然后把它攪匀加入白明胶中，攪拌均匀，再将鉻酸溶液、重鉻酸銨溶液加入，攪拌后用紗布滤过，貯存于棕色瓶中。配成的溶液只能貯存4~5天，最好随配隨用，日子久了会变质。

(3) 上感光胶 根据底板面积大小，在底板中間倒上适量的感光液，慢慢地使胶液流滿底板四面；再重复澆上一次感光液，使板面均匀流滿胶液，再将底板放在电动或手搖的离心机上。离心机的中心装一橡皮吸碗，将底板吸住，用每分鐘150~200 轉的轉速旋轉，并用热吹风一面旋轉一面吹干板面胶液。

离心机的轉速对感光胶的厚薄有决定性影响，若轉得很快，感光胶层将太薄，下一步进行腐蝕时，可能被蝕去；若轉得太慢，得到的胶层太厚，在显影时可能与板面脱离。板面上的感光液必須經

充分干燥，否则在晒印时会与底片粘牢；但也不能过于干燥，太干燥会引起感光胶层变质，显影时会发生困难。简单的试验干燥是否适当，可用手指揿压胶面，试验是否粘手，以不粘手指为度。

(4) 晒印 曝光时间决定于光的强弱，曝光的光源可用炭精灯或日光，感光时间与前面光化学制丝网工艺相同。另外还可以用照相用的 200 瓦强光泡 4 只，装在一只反光罩内，作为光源。但曝光时底片架与灯光的距离，要保持 250~300 毫米之间，不要太近，因灯光的热度很高，太近了会损坏架子及底片。用灯光曝光的时间，应先通过试验来确定，一般以 10 分钟为宜。

(5) 上油墨 曝光后的底板，从架子内取出，平放在台上，用橡皮滚筒很均匀地滚上一薄层油墨，油墨最好用石印油墨。滚上的油墨层不得有针孔及堆聚痕迹，也不得太厚，厚了会使线路模糊。

(6) 上红粉 红粉是一种天然树脂，又名麒麟血；此外如硬瀝青、松香粉，都可以用。这种粉的主要作用是加强油墨耐腐蚀性，不论用哪种粉都能达到要求，粉的细度是越细越好，最低限度是要通过 140 目筛孔。上粉方法是底板滚好一层油墨后即洒上一层；洒好后将底板侧过来，将多余的粉倒去即成。

(7) 显影 将上过粉的底板，放进装有冷水的盘中。用棉花浸在水中在板面上轻轻地擦抹，未受光作用的地方就会溶解，连同油墨一同脱下。这样，曝过光的线路图形就显出来了，再用水缓缓地冲洗清楚。

(8) 烘固 显影完毕，将底板上的水甩干，放在干燥箱中用 70°C 左右的温度来烘干。烘去水分后即取出来，再洒上一层滑石粉，再放进烘箱以 80~90°C 的温度来烘熔红粉即成。

(9) 修整 烘好的底板，从烘箱中取出，将上面的滑石粉拂去，检查是否有损坏的地方，如有损坏处须进行修整。修整时可用 20% 的聚苯乙烯甲苯溶液进行修整，修整之后就可进行腐蚀。

1-3 胶版轉印法

这种方法和印刷工业中的胶版印刷法相同，用这种方法印出的线路图形比丝网印刷法精密，比照相版法稍差。这种方法适合大量生产，但设备费用较大，不适用于小量生产及研究室用。这种工艺的制版方法和上面照相版方法相同，将图形用照相法晒制在铝板上，但不进行腐蚀，只用纱布沾水将版面润湿。因为板面上的线路图形涂有油墨，不会沾水的，其余板面上因没有油墨，会沾上一层水。再用橡皮滚筒均匀地向板面滚上一层油墨，铝板上因有水的关系，油墨涂不上去；线路上因原来有油墨，所以能涂上油墨。另外再用一只清洁滚筒，从板面上滚过，板面上线路图形就转印到清洁胶滚筒上去了。再将这个滚筒去印底板，就可将线路转印过去，这样不断地润湿水、上油墨、印底板，就是胶版转印工艺。

1-4 描 繪 法

在大量生产前试制样子，或在研究、试验工作上，用这种工艺是最简便的方法，可免去制版等一系列的工艺。若在设计大量生产之前，用这种方法先做一块样子，先装置样机，经过试验改进后，再投入生产试制，这样可以免去因设计不完善而造成浪费。

描繪所用的涂料配方如下：

| | |
|------|------------------|
| 聚苯乙烯 | 20 克(即做发梳等的硬性塑料) |
| 甲苯 | 50 毫升 |
| 二甲苯 | 30 毫升 |
| 油溶性红 | 0.1 克 |

先将甲苯与二甲苯混和，再加入聚苯乙烯及颜料，将瓶塞紧，每半小时摇动一次，直至完全溶解后为止。使用时可用毛笔随意描繪，很快就会干燥。用后必须将瓶盖紧以免溶剂挥发。描上的线路干燥后，可用尖刀将线路修整妥善，即可进行腐蚀。

2. 銅箔腐蝕法工藝

銅箔腐蝕法是目前應用較廣的方法，整個工藝和徽章廠、印刷制版廠的工藝大致相同。這種工藝優點是精密度高。

銅箔腐蝕法是印刷電路最早使用的工藝方法，因為用這種工藝方法製成的線路，在技術上經得起考驗，能符合電性能的要求，所以能保留下來，而且還是印刷電路中主要的工藝方法。但這種方法也是有缺點需要改進的，例如腐蝕中需要大量的腐蝕液，浪費了很多的金屬銅等。

採用銅箔腐蝕法工藝時所使用的底板可自己來製造。底板上的金屬箔，可用電鍍法和機械軋制法來製造。但因為這種銅箔要求很高，所以最主要的是應把它平整地粘在絕緣板上。若用機械軋制的銅箔，很難達到要求，其次是附着強度較差。電鍍的工藝如下：

一、底板準備

用于印刷電路絕緣底板的材料，必須要有好的電氣性能，一般層壓紙膠板、層壓布膠板、玻璃纖維層壓板等都可以用。但必須表面平整，不能有凹凸和彎曲，最好是採用吸水性小的玻璃纖維布層壓板。

板子在工藝上最好面積不要太大，一般應不超過3平方分米，否則容易發生彎曲，厚度以1.5~3毫米為佳，太厚造成浪費，薄了機械強度不高。

若用現成帶有銅箔的底板，需經過剪裁、沖眼等手續。在實驗

室可用鋸子鋸裁。進行鋸裁、冲眼工藝時，銅箔的一面必須朝上，免得銅箔脫離底板。製造粘有銅箔的底板的方法有機械法和電鍍法兩種。前面已談過，用機械法要保證平整是比較困難的。現在介紹的是電鍍法，這個方法比較簡單而質量也較高。用電鍍法制出的銅箔，一面是光的一面是毛的，毛的一面很適合于膠粘工藝的要求，可增加附着強度。電鍍法製造銅箔及底板的工藝如下：

(1) 電板板工藝 電鍍時用不鏽鋼板做陰極，陽極用電解銅。不鏽鋼板經過電鍍後在面上鍍上一層銅，因為銅層在不鏽鋼上面附着性不強，因此可以再用粘合劑粘到絕緣板上去。其方法是用厚1~1.5毫米的不鏽鋼板，裁成需要的尺寸，一般在6平方分米以內，面積小加工容易，大了膠粘到絕緣板上時不易達到技術上的要求。

裁好的不鏽鋼板必須平整，表面要光潔，要經過拋光，或用木炭磨光。使用時將平整光亮的不鏽鋼板，用苯或四氯化碳洗去油污，然後上一層極薄的蠟。上蠟方法是將白蠟加熱到200°C左右，將不鏽鋼板放入蠟內浸1分鐘即行取出，但又必須達到不鏽鋼板上看不出有蠟迹為合格。若有蠟迹是溫度不够高所致，可在烘箱中加熱烘去，上蠟的作用是便於將鍍上去的銅層取下轉移到層壓板上去，免得銅層附着在不鏽鋼板上。

上好蠟的不鏽鋼板用夾具夾緊後，即可放入電鍍槽內電鍍。

(2) 電鍍 鍍銅液的配方：

硫酸銅 200克/升

硫酸 50克/升

電流密度 2~5安/平方分米

普通的電鍍可用以上配方，若在工業生產時考慮到電鍍的質量和時間，可增高電流密度及硫酸銅濃度；但增高硫酸銅濃度後陽極板很易引起極化，高電流密度鍍出來的銅層不緊密。要免去這兩種缺點，電鍍液中可加入附加劑膠及苯酚磷酸，還可用周期回流